# Rockchip USB 2.0 一致性测试指南

文件标识: RK-CS-YF-129

发布版本: V1.0.0

日期: 2020-10-09

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有© 2020瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: <u>fae@rock-chips.com</u>

#### 前言

#### 概述

本文档提供 Rockchip 平台 USB 2.0 的一致性测试方法。根据 USB-IF (USB Implementers Forum) 发布的规范,USB 2.0 一致性测试包括如下三个部分<sup>[1]</sup>:

- 功能特性测试 Functional
- 电气特性测试 Electrical
- 互通特性测试 Interoperability

本文档将说明每一项 USB 2.0 测试的主要内容和测试方法。

同时,本文档还简单介绍了 USB 认证的流程。

#### 产品版本

芯片名称	内核版本
所有芯片(包括 29 系列、30 系列、31 系列、32 系列、33 系列、PX 系列、RV 系列、MCU)	所有内核版 本

#### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

硬件开发工程师

#### 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2020-10-09	V1.0.0	吴良峰	初始版本

#### 目录

### Rockchip USB 2.0 一致性测试指南

- 1. USB 2.0 功能特性测试
- 2. USB 2.0 电气特性测试
- 3. USB 2.0 互通特性测试
- 4. USB 2.0 认证
- 5. 参考文献

### 1. USB 2.0 功能特性测试

USB 2.0 功能性测试:主要测试产品的功能是否完整,USB-IF 提供了功能性测试工具 USB20CV (USB 2.0 Command Verifier) 用于评估高速,全速和低速 USB 设备是否符合 USB 设备框架(第 9 章),集线器设备类(第 11 章),HID 类和 OTG 规范。还包括大容量存储类和 USB 视频类测试规范。所有 USB 外设和集线器都必须通过设备框架测试才能获得认证。

USB20CV 工具只支持Windows系统,下载地址如下:

- USB20CV 32-bit Windows
- USB20CV 64-bit Windows

注意: 仅 Windows 7 和更高版本支持 USB20CV 工具,并且该工具需要计算机支持增强型主机控制器接口 EHCI。

### 2. USB 2.0 电气特性测试

USB 2.0 电气特性测试:主要测试产品的电气信号,USB 2.0 电气测试规范为 USB 2.0 产品定义了一组电气测试标准<sup>[2][3]</sup>,所有 USB 产品都必须通过 USB 电气特性测试,才能获得 USB-IF 的认证。

USB 2.0 的电气特性测试需要覆盖高速,全速和低速三种信号,对应的测试规范如下:

- 低速/全速电气测试规范:《USB-IF Full and Low Speed Electrical and Interoperability Compliance Test Procedure》
- 高速电气测试规范: <u>《USB 2.0 Electrical Compliance Test Specification》</u>

测试 USB 2.0 电气特性,需要使用 USB-IF 认可的示波器供应商

- Keysight
- Rohde & Schwarz
- Tektronix
- Teledyne LeCroy

根据 USB 2.0 电气特性规范的要求,建议执行如下表1的测试项。

表1 USB 2.0 电气特性主要测试项

测试项	测试要求
Device HS Signal Quality Test	参考文献[2] EL_2 EL_4 EL_5 Data Eye and Mask Test EL_6 Device Rise Time EL_6 Device Fall Time EL_7 Device Non-Monotonic Edge Test
Device HS Packet Parameters	参考文献[2] EL_21 Sync Field Length Test EL_25 EOP Length Test EL_22 Measure Interpacket Gap Between Second and Third Packets EL_22 Measure Interpacket Gap Between First and Second Packets
Device HS Device CHIRP Timing	参考文献[2] EL_28 Measure Device CHIRP-K Latency EL_29 Measure Device CHIRP-K Duration EL_31 Hi-Speed Terminations Enable and D+ Disconnect Time
Device HS Suspend/Resume/Reset Timing	参考文献[2] EL_38 EL_39 Suspend Timing Response EL_40 Resume Timing Response EL_27 Device CHIRP Response to Reset from Hi- Speed EL_28 Device CHIRP Response to Reset from Suspend
Device HS Test J/K, SE0_NAK	参考文献[2] EL_8 J Test EL_8 K Test EL_9 SE0_NAK Test
Device HS Receiver Sensitivity	参考文献[2] EL_18 Receiver sensitivity Test - Minimum SYNC Field EL_17 Receiver sensitivity Test EL_16 Receiver sensitivity Test @ Squelch
Host HS Signal Quality	参考文献[2] EL_6 Rise Time EL_6 Fall Time EL_3 Data Eye and Mask Test EL_7 Non-Monotonic Edge Test

测试项	测试要求
Host HS Packet Parameters	参考文献[2] EL_21 Sync Field Length Test EL_25 EOP Length Test EL_23 Inter-packet Gap Between First 2 Packets Test EL_22 Inter-packet Gap Between 2nd and 3rd Packet Test EL_55 SOF EOP Width Test
Host HS Disconnect Detect	参考文献[2] EL_37 Disconnect Detect Test At 525mV Threshold EL_36 Disconnect Detect Test At 625mV Threshold
Host HS CHIRP Timing	参考文献[2] EL_33 CHIRP Timing Response EL_34 CHIRP K Width EL_34 CHIRP J Width EL_35 SOF Timing Response
Host HS Suspend/Resume Timing	参考文献[2] EL_39 Suspend Timing Response EL_41 Resume Timing Response
Host HS Test J/K, SE0_NAK	参考文献[2] EL_8 J Test EL_8 K Test EL_9 SE0_NAK Test
Host LS/FS Inrush Current Test	参考文献[3] B.4 Inrush Current Testing
Host FS Signal Quality Test	参考文献[3] B.3.3.1 Low-speed Downstream Signal Quality Test
Host LS Signal Quality Test	参考文献[3] B.3.3.2 Full-speed Downstream Signal Quality Test

根据表1,可以看出 USB 2.0 的电气特性测试,主要是测试高速信号质量。USB-IF 提供了基于 Windows 的 HSETT (High-Speed Electrical Test Tool) 实用程序,用于测试 USB 高速信号,下载地址如下:

- EHSETT 32-bit version
- EHSETT 64-bit version
- XHSETT 32-bit version
- XHSETT 64-bit version

工具的使用说明,请参考如下的文档:

HSET Documentation version 0.41 for EHCI and xHCI

注意:

在进行 Device/Host HS Signal Quality 测试时,需要设置待测 USB 设备进入测试模式(Test Packet Mode),才能触发正确的测试信号。Rockchip 平台的 USB 控制器支持使用测试命令和测试工具 HSETT 两种方式,具体要求如下:

- USB 2.0 Device,可以使用测试命令或者测试工具设置 USB 控制器进入 Test Packet Mode
- USB 2.0 Host,只能使用测试命令设置 USB 控制器进入 Test Packet Mode

测试命令请参考文档 《Rockchip\_Developer\_Guide\_USB\_SQ\_Test\_CN》的章节"USB 2.0 测试命令和测试工具"。

### 3. USB 2.0 互通特性测试

USB 2.0 互通特性测试:主要测试 USB 设备在不同的软件操作系统和不同硬件控制器下的兼容性。可能会使用"Gold Tree"上的一些设备来做互操作性测试,以测试设备和不同主机的兼容性,如设备在使用EHCI 控制器的主机下能否枚举成功等。

因为 USB-IF 对 USB 2.0 互通性测试没有强制性要求,所以本文档不对互通性测试作详细说明。如果读者想进一步了解 USB 2.0 的互通特性的测试方法,请参考如下规范:

<u>«xHCI Interoperability Test Procedures For Peripherals, Hubs and Hosts Version</u>

### 4. USB 2.0 认证

USB 2.0 认证是指 USB 产品通过 USB-IF 所规定的特定测试,并获得使用 USB 标志的授权。产品接收测试的方法有两种:

- 参加 USB-IF 赞助的兼容性测试大会
- USB-IF 认可的测试实验室

可以从网站 <a href="https://www.usb.org/labs">https://www.usb.org/labs</a> 找到符合 USB-IF 要求的独立测试实验室。当产品通过兼容性测试后,它就会获得一个 USB 协会测试号(TESTING ID, TID),通过这个 TID,可以在 USB-IF 官网上查到这个测试设备的相关信息,并有权使用 USB 标志。

USB 兼容性测试认证的一般流程如下:

- 申请成为 USB-IF 会员,获取供应商识别码(Vendor ID, VID);
- 准备 USB 兼容性测试清单;
- 送 USB-IF 授权的独立测试实验室进行测试;
- 获得合格报告及证书;
- 使用相应的 USB 标志;

注意:Rockchip 是 USB-IF 的会员,VID 为 0x2207,并且,SDK USB 默认配置的 VID 也是 0x2207,但该 VID 供产品开发和调试使用,无法授权给开发者使用。如果产品需要过 USB-IF 认证,需要开发者独立申请成为 USB-IF 会员,以获取唯一的 Vendor ID。

## 5. 参考文献

- 1. <u>USB 2.0 Testing Information</u>
- 2. USB 2.0 Electrical Compliance Test Specification
- 3. <u>USB-IF Full and Low Speed Electrical and Interoperability Compliance Test Procedure</u>
- 4. <u>HSET Documentation version 0.41 for EHCI and xHCI</u>
- 5. 《Rockchip\_Developer\_Guide\_USB\_SQ\_Test\_CN》